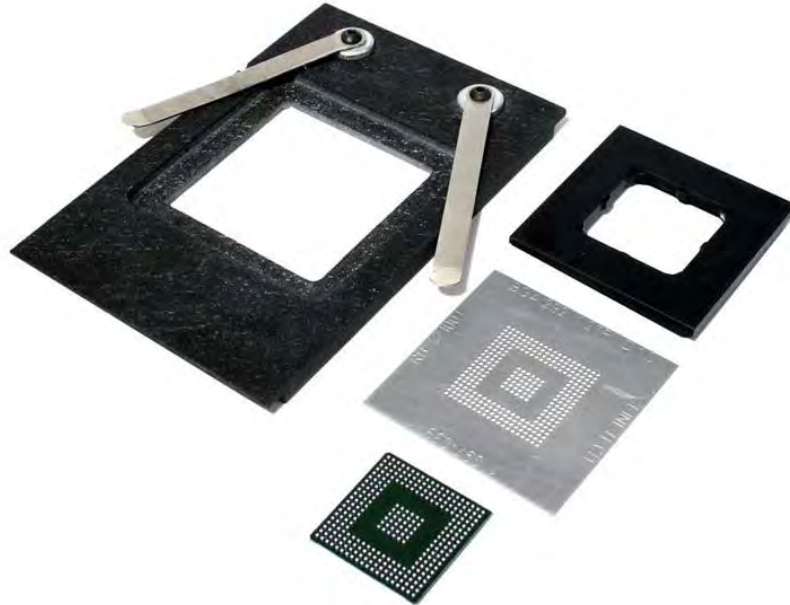


FINEPLACER® Reballing-Modul



Das Reballing-Modul erlaubt es, nach der Restlotentfernung neue Lotball-Arrays auf wiederverwendete BGA oder CSP Bauteile aufzubringen.

Das Modul nutzt dabei das Ober- und Unterheizungssystem des Reworksystems für reproduzierbare Ergebnisse.

Die Ausrichtung von Schablone und Bauteil-Pads erfolgt über das optische System des FINEPLACER®.

Eigenschaften*

- Präzises Reballen
- Reproduzierbare Ergebnisse
- Schafft Atmosphäre ähnlich Reflow-Ofen
- Einsatz von Inertgas möglich
- Minimale thermische Belastung des Bauteils
- Optional Bauteil-Vakuum verfügbar
- Für alle Bauelementgrößen
- Für Ballgrößen 250 µm – 760 µm

* je nach Konfiguration